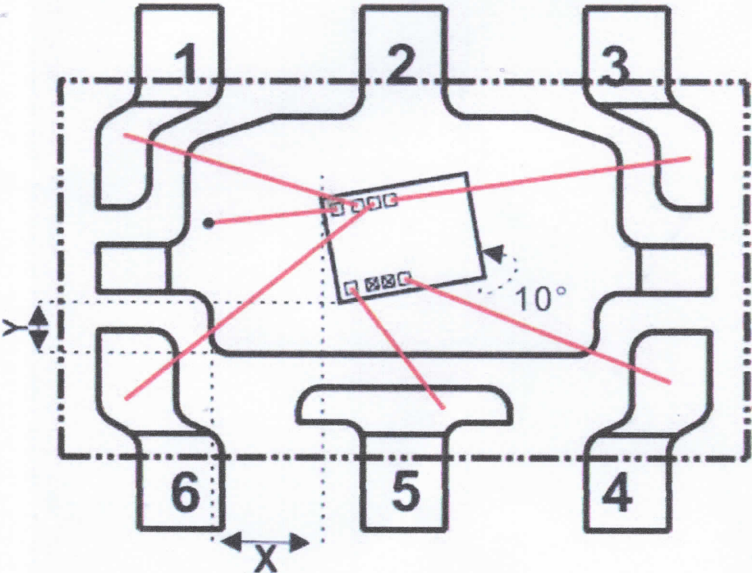
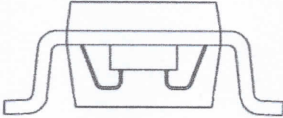
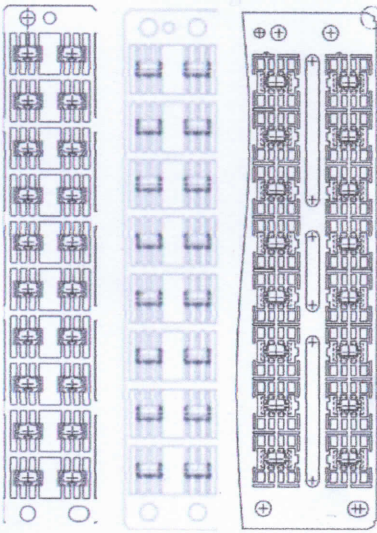

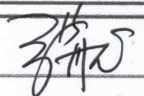


<div><div>HX</div><div>汉芯科技</div></div>		山东汉芯科技有限公司		文件编号		BD-HXQ73-SOT236001			
		ShanDong HanXin Technology Co., Ltd		文件名称		SOT23-6L 焊线图			
		TEL:0632-7528601 FAX:0632-7528604							
芯片型号	HS6001	产品名称	HS16P1880		客户代码	HXQ73	版本	A	
版本信息:									
版本	修改内容				修改日期	修改人			
A	初版发行				2024-08-26	郭剑			
<div></div>					框架规格	X offset	Y offset		
					10 排(40*72)	0.45±0.1mm	0.20±0.1mm		
					8 排 (36*63)	0.43±0.1mm	0.15±0.1mm		
					8 排 (40*63)	0.43±0.1mm	0.20±0.1mm		
<div><div>Side View</div><div></div></div>					Top View				
					<div><div>PB1 VDD PB3</div><div><div>6</div><div>5</div><div>4</div></div><div>MARK</div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div></div><div>PB0 GND PB2</div></div>				
项 目	参数信息		<div><div></div><div>416 颗 288 颗</div><div>10 排进料方向 8 排进料方向</div></div>			备注:			
划片道宽度	60um					DB 注意: 芯片逆时针旋转 10 度			
框架规格	10 排: 40*72mil ² (480 颗) 8 排: 36*63mil ² (416 颗) 8 排: 40*63mil ² (288 颗)					PAD(焊盘)铝层厚度: 1.2um			
粘胶型号	导电胶					PAD 下方是否有敏感器件? √ 有 无			
芯片尺寸	625*450um ² (含划片道)					客户注意:			
芯片厚度	220±10um					焊接时, PAD 下方或附近有敏感器件时, 压焊会影响成品率和可靠性。			
焊点尺寸	49*49um ²					<input type="checkbox"/> 试产 <input type="checkbox"/> 直接量产			
焊点间距	59um					(直接量产我司不予保证良率)			
焊线根数	6 根					客户确认签字:			
焊线总长	NA								
焊线线径	合金线/20um								
制定	郭剑	审核	<div></div>	批准	<div></div>				
制定日期	2024-08-26	审核日期	2024.08.26	批准日期	2024.08.27				